



東京大學與台積公司宣布於先進半導體技術進行組織性合作

發佈單位：東京大學、台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2019年11月27日

東京大學與台積公司今（27）日宣布締結聯盟，在先進半導體技術上進行組織性的合作。在此聯盟之中，台積公司將提供晶圓共乘（CyberShuttle[®]）服務給東京大學工程學院的系統設計實驗室（Systems Design Lab, d.lab），該實驗室亦將採用台積公司的開放創新平台虛擬設計環境（VDE）進行晶片設計。此外，東京大學的研究人員與台積公司的研發人員將建立合作平台，來共同研究支援未來運算的半導體技術。

2019年10月甫成立的東京大學設計實驗室是一個結合產學合作的研究組織，協同設計專門且特定應用的晶片，以支援未來知識密集的社會。以此設計實驗室做為設計中心，東京大學與台積公司締結的聯盟則使其產生的各種設計得以轉換成功能完備的晶片。台積公司的虛擬設計環境提供此實驗室的創新人員完備的設計架構，為一安全且有彈性的雲端設計環境，而晶圓共乘服務更大幅降低了利用半導體產業最先進製程生產的原型晶片的進入門檻。

此外，東京大學與台積公司計畫在材料、物理、化學、以及其他領域進行先進研究的合作，持續推動半導體技術的微縮，同時也探索推動半導體技術往前邁進的其他途徑。雙方的合作已於2019年11月1日在台積新竹廠區舉辦的研討會中開啟序章，來自東京大學各相關學科領域的研究人員與台積公司的技術專家共同與會，確認雙方在研究合作上的可能機會，替彼此未來的合作專案鋪路。

東京大學校長五神真表示：「日本產業正在進行典範轉移，邁向知識密集的社會，這次與台積公司結盟，讓我們能夠與全世界最先進的晶圓廠連結，為實現日本社會5.0的國家策略盡一份力。我們很高興能與台積電，這樣一個全球領先的半導體公司合作，建立跨國界的產學聯盟。」

台積公司董事長劉德音博士表示：「在半導體產業中，有許多提升半導體技術的途徑值得業界探索，而台積公司一直積極地與全球許多頂尖的學術機構合作，我們非常高興東京大學成為我們的夥伴之一。台積公司於半導體產業中的角色為協助更多的創新者釋放創新能量，我相信透過台積公司與東京大學的結盟，將會使許多創新的想法落實為具體的產品，讓我們的社會變得更豐富美好。」

關於東京大學

東京大學成立於1877年，是日本第一所國立綜合性大學。作為領先的研究型大學，東京大學提供的課程包括本科生和研究生的所有學科，進行的研究涵蓋全面性的學術研究。東京大學致力於為莘莘學子提供豐富且多樣的學術氛圍，確保智力開發和專業知識技術學習的機會。更多關於東京大學的資訊，請至 <https://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/about.html>。



關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，並一直是全球最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以業界先進的製程技術及設計解決方案組合支援一個蓬勃發展的客戶及夥伴的生態系統，以此釋放全球半導體產業的創新。

2019 年，台積公司全球總產能超過 1,200 萬片之十二吋晶圓約當量，台積公司並提供最廣泛的製程技術，全面涵蓋自 2 微米製程至最先進的製程技術，即現今的 7 奈米製程。台積公司係首家提供 7 奈米製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司，同時亦領先業界導入極紫外光（EUV）微影技術協助客戶產品大量進入市場。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 www.tsmc.com.tw 查詢。

#

國立大學法人東京大學
社會連携部 社會連携推進課
Tel: 81-3-3815-8345
Fax: 881-3-5841-1054
E-mail: ext-info.adm@gs.mail.u-
tokyo.ac.jp

國立大學法人東京大學
工學系研究科 廣報室
Tel: 81-3-5841-6295
E-mail: kouhou@pr.t.u-
tokyo.ac.jp

台積公司代理發言人：
孫又文
企業訊息處資深處長
Tel: 03-568-2085
Mobile: 0988-937-999
E-Mail: elizabeth_sun@tsmc.com

台積公司新聞連絡人：
孔培德
公共關係部專案副理
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5031
Mobile: 0988-931-352
E-Mail: pdkramer@tsmc.com